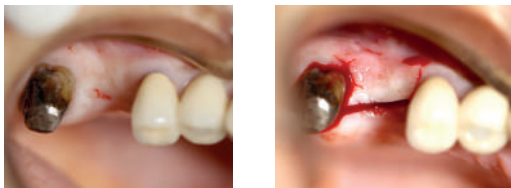


Technique du Dr Baranes D.

Élévation du plancher du sinus lorsque la hauteur initiale d'os sous sinusien est supérieure ou égale à 4 mm.

Réalisation d'un lambeau d'épaisseur totale, à l'aide d'une incision crestale légèrement déplacée en Palatin et et de



Il faut visualiser le mur osseux vestibulaire



Monter une fraise B.Y.S 2,8 mm sur contrangle pour micro tour d'implantologie.

Vitesse de travail de 400 à 800 tours minute avec irrigation externe.

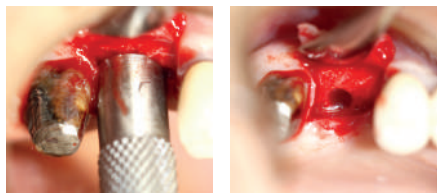
Forer un Pertuis de 4 mm de longueur.

Si l'os est de type D1 ou D2 forer avec un foret classique un pertuis de 2,8mm de diamètre et de 3 mm de longueur.

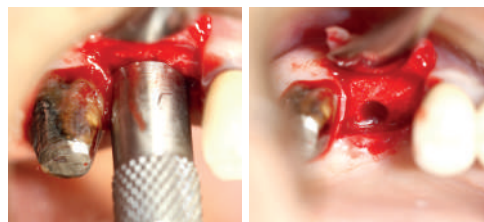
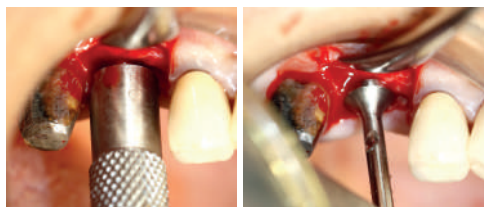
Puis finir le pertuis avec la B.Y.S 4



Prendre un ostéotome de 3,2 mm de diamètre régler la butée à 5 mm, Si la butée touche la crête vous avez déjà repoussé la membrane, régler votre ostéotome à 6 mm puis 7 mm puis 8 ,9 et 10 mm.



Si la butée de votre ostéotome reste distante de la crête, prenez la fraise B.Y.S 5, et forer un pertuis de 5 mm de longueur, prenez un ostéotome de 3,2 mm de diamètre et de 6 mm de longueur, etc...



Greffer le Bond Apatite.

Activer la seringue de Bond Apatite et déposer le matériau dans un godet stérile. Appuyer avec une compresse sèche sur le matériau pour absorber le liquide résiduel.



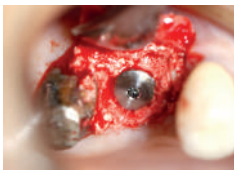


Remplir la seringue porteuse d'os, et déposer le Bond Apatite à l'embouchure du Pertuis.

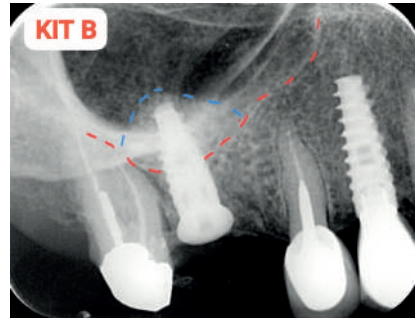


Greffer le Bond Apatite en le poussant à l'aide d'un ostéotome 3,2 mm dont la butée est réglée sur la hauteur du dernier ostéotome utilisé pour repousser la membrane moins 1 mm.

Puis répéter l'opération trois à quatre fois en prenant soin de toujours retirer 1 mm de votre ostéotome avant de pousser le nouveau greffon de Bond Apatite, puis mettez votre implant.



Sutures



Radio péri apicale.  
Implant 4.2 / 11.5 mm

